

Träger zum Sintern von DBC-Großkarten.



Träger zum Sintern von Einzelsubstraten.

Applikations- und F&E-Leistungen von PiNK Für Löt- und Sintertechnik

Innerhalb eines schnell wachsenden und wettbewerbsintensiven Marktes, sind beschleunigte Entwicklungszyklen für profitable und zuverlässige Prozesse unabdingbar, um den stetig wachsenden Anforderungen an moderne Elektronik-Bauelemente gerecht zu werden.

PiNK unterstützt seine Kunden von der Packaging- und Prozessentwicklung bis hin zur Serienfertigung. Über Anlagen-Demonstrationen sowie Löt- und Sinterversuche hinaus bietet PiNK auch Machbarkeitsstudien für neue Aufbau- und Verbindungstechniken und Musteraufbauten an. Dies ermöglicht die Bewertung und frühzeitige Verbesserung von Taktzeit, Durchsatz und Qualität. Das erarbeitete Prozesswissen wird den Technikern und Ingenieuren des Kunden durch Schulungen vermittelt.

Leistungsspektrum

- Beratung und Konzeptentwicklung
- Versuche und Demonstrationen
- Machbarkeitsstudien
- Aufbauen von Prototypen
- Prozessentwicklung
- Schulungen und Support

Verbindungstechnologie-Anwendungen

- (Leistungs-)Halbleiteranbindungen
- Substrate auf Bodenplatten
- Oberseitige Halbleiterkontaktierungen
- Doppelseitige Module
- Multi-Layer-Konzepte

PiNK-Equipment

- VADU-Vakuumlötanlagen
- Sinteranlage SIN 200+
- Plasma-Reinigungsanlagen

Zusätzliches Equipment

- Bestückungsautomat
- Schablonendrucker

Eigene Testsubstrate

- DBC's mit Au-, Ag-, Cu-Metallisierung
- Dummy Si-Chips
- Cu-Leadframes

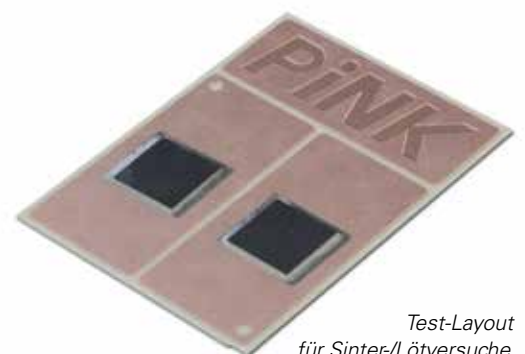
Interne Qualitätskontrolle

- Mikroskopie
- Dornbiegetest
- Bestimmung der Oberflächenspannung
- IR-Kamera

Externe Untersuchungen

- Röntgen
- Ultraschallmikroskopie
- Scher-Tests
- Querschliffuntersuchungen
- REM/EDX Untersuchungen

PiNK GmbH
Thermosysteme
 Am Kessler 6
 97877 Wertheim
 Germany
 T +49 (0) 93 42 919-0
 F +49 (0) 93 42 919-111
 application@pink.de
 www.pink.de



Test-Layout für Sinter-/Lötversuche.